

M-VIA Flex® FR4-Flex基板

Semiflex PWB

特長 Features

- ✓ FR-4.0、4.1のプリント配線板材料で屈曲できる基板
Bendable PWB with FR-4.0, 4.1 Material



コンセプト Concept

フレックスリジッド基板より簡素プロセス
Simpler Process than Flex-Rigid

同一接続(コネクタレス)
Single Board Connection (Connector Less)

ポリイミド材レス通常PWB材料
Ordinary PWB Material (PI less)

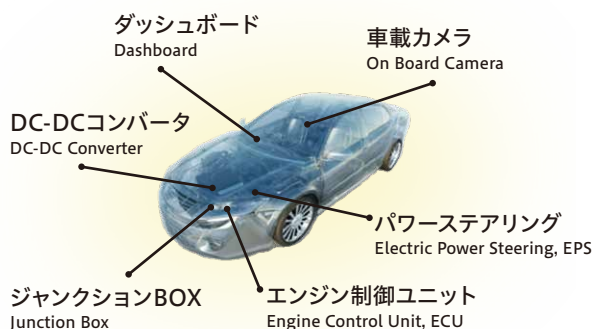
製品メリット Merit

小型化 & 省スペース化
Small & Space Saving

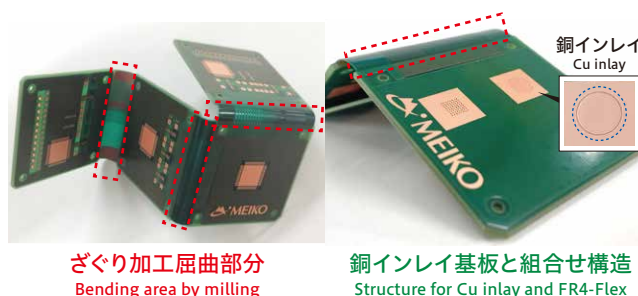
低コスト化
Low Cost

回路信号の低損失化
Transmission Loss Reduction

用途 Application



基板屈曲例 Examples of Bendable PWB

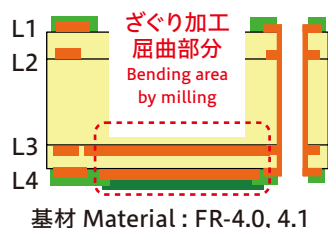


基板仕様 Board Specification

項目 Item	仕様 Specification
層構成 Stack-up	2~8層 2~8 layers PWB
Flex部 層構成 Flex stack-up	1~2層 (内層銅箔Max70μm) 1~2 layers (Inner Cu foil Max70μm)
曲げ角度 Bending Angle	~90°、~180° ~90 degrees, ~180 degrees
曲げ回数 Bending cycle	Typ. 1~3回 Typical 1~3 times

信頼性評価 Reliability Evaluation	条件 Condition	結果 Result
熱衝撃試験 RTC	+150℃ 30min. / -55℃ 30min.	3,000 cycles pass
耐電食試験 CAF	+85℃85% 100V	1,000h pass
高温放置試験 HTST	+125℃	1,000h pass
ホットオイル試験 Hot Oil	+260℃5sec. / 15sec. / +20℃20sec.	100 cycles pass

■断面図(4層基板, Flex部2層例) Cross Section (ex. 4-layer PWB, 2-layer flex)



■開発テーマ(高電流対応、高密度化) R&D Development Themes (High current, High density) R&D

